

2014年3月期 第2四半期 決算説明会

2013年11月13日

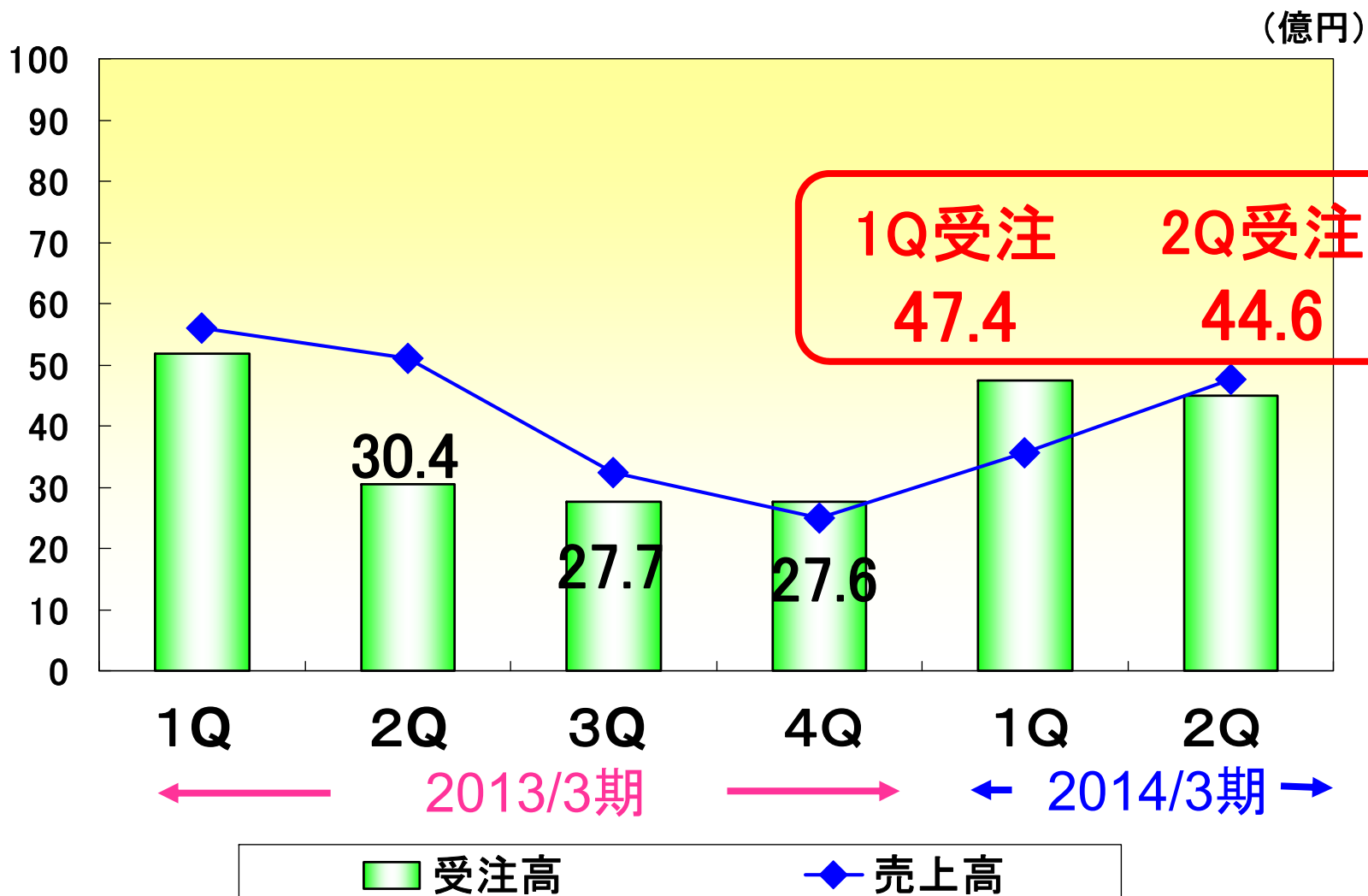
TOWA株式会社

東証1部:6315

上期を振り返って

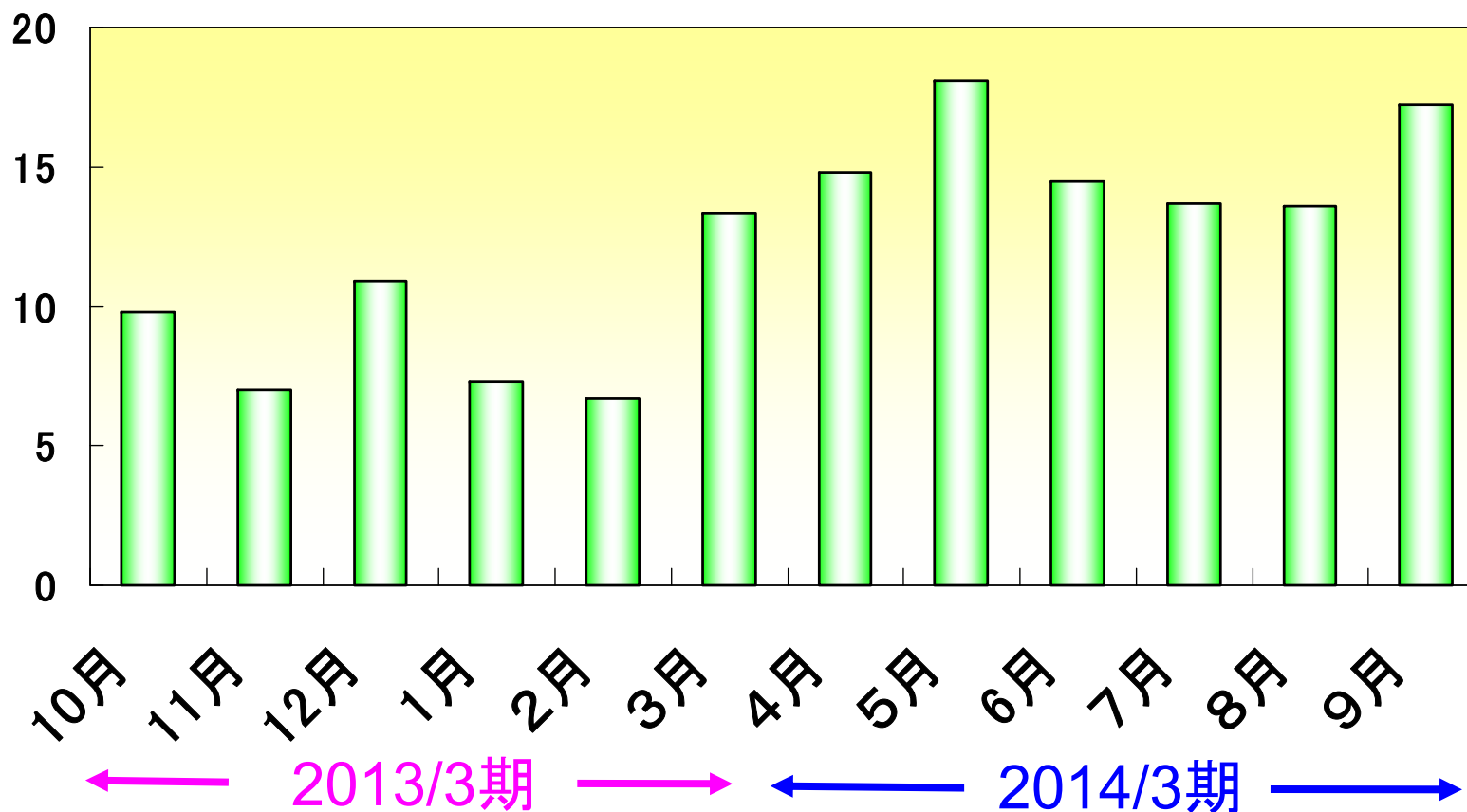
- 受注高・売上高の推移
- シンギュレーション事業
- リピート金型戦略の実績
- コンプレッション技術への投資
- 攻めの経営は継続

受注高・売上高の推移



(月次) 受注高推移

(億円)



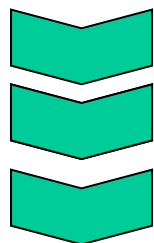
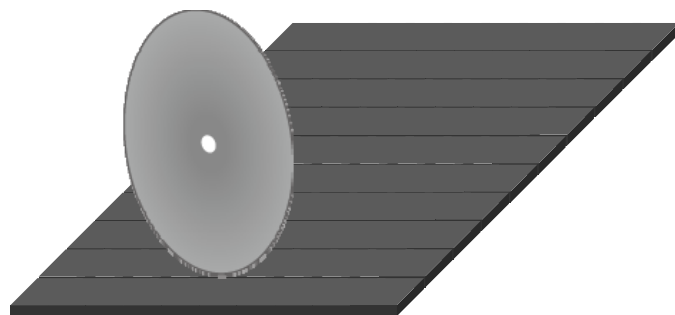
1月～2月で底打ち、市況は反転

2014/3期 第2四半期(累計)連結業績

(億円)

	期 初 計 画	実 績
売 上 高	80.0	83.3
営 業 利 益	2.0	0.7
経 常 利 益	1.9	1.0
四 半 期 純 利 益	1.2	0.5

新規参入 シンギュレーション事業



上期売上実績
3.6億円

【課題】

- ・さらに他社との差別化を図る
- ・円安メリットの価格転嫁
- ・安定した収益貢献

リピート金型 売上実績

単位：型数

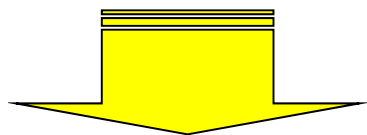
前下期実績	上期実績	(上期計画)
132	237	(185)

戦略価格・専用生産ラインによる「**リピート金型戦略**」は
順調に展開できた → **受注型数は増加。**

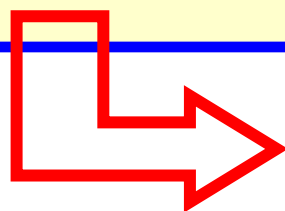
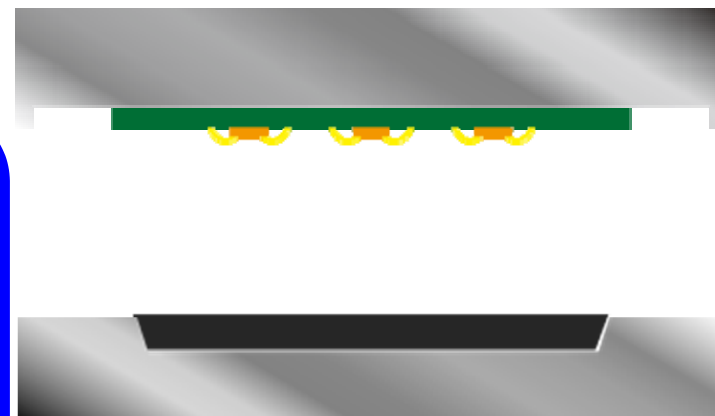
コンプレッション技術への投資を拡大

次世代PKGへの対応

⇒ コンプレッションが必ず主役となる



パネルモールド対応
12インチFOWLPLP
ファブレスからの技術要請



開発費(原価処理)が膨らむ

● TOWA韓国株式会社の新規設立

お客様への**技術サポート**を伴った**営業活動**の展開が可能となる体制を構築。

株式会社東進(前期に連結子会社化)との**製販一体**となった活動も推進。

● 合併会社(台湾)の連結子会社化

会社名 : **巨東精技股份有限公司**

株主構成 : TOWA株式会社

JIPAL CORPORATION

40%→**60%**

60%→40%

●中国市場への新製品(マーケットイン型)投入

新製品名 : YLC-1120

- トランスファ方式
- 120t プレス

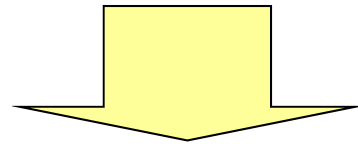
特徴

- 機能やオプション余地を限定
- 中国現地部材90%以上
- 現地生産・現地出荷

⇒ **戦略価格での販売が可能**

TOWA Europe B.V.(オランダ)新規設立

ドイツ(デュッセルドルフ)の販売事業会社を移設。
パッケージ開発用の評価ラボを設置。



- ☆ 北米ファブレスへの仕掛けが成功
- ☆ ヨーロッパでもR&Dにアプローチ
- ☆ パッケージ開発段階から紐帯を築く

上期のサマリー

- 受注・売上は概ね順調に推移
 - ・半導体市場が不安定な中、**コンプレッションの製品群が強みに**
- シンギュレーションに甘さがあった
 - ・**収益性**を含めた完成度を高める必要あり
- 必要な経営施策は確実に実行
 - ・**主要マーケットへの営業展開(韓国・台湾・中国・欧州)**
 - ・**コンプレッションへの積極投資(次世代PKG対応)**

下期の市況予想

- 後工程への投資は横ばい

下期受注見込み⇒上期とほぼ同水準

- 主要マーケットの立ち上がり

⇒4Q以降

設備投資が下期に伸張する環境にはない

10/31付 業績予想の修正

(億円)

	2 実	Q 績	下 計	期 画	下 修	期 正	通 修	期 正
売上高	83.3		105.0		86.7		170.0	
営業利益	0.7		9.0		1.7		2.4	
経常利益	1.0		8.1		1.7		2.7	
当期純利益	0.5		7.8		1.7		2.2	

2014/3期 修正(セグメント別)

(億円)

		期初 計画	上期 実績	下期 見込	通期 予想
売上高		185.0	83.3	86.7	170.0
	半導体製造用 等精密金型	63.0	31.7	34.0	65.7
	半導体 製造装置	82.7	34.9	38.9	73.8
	LED樹脂封止 装置・金型	10.9	5.7	3.5	9.2
	シンギュレー ション装置	16.6	3.7	4.1	7.8
	ファインプラス チック成型品	11.8	7.3	6.2	13.5

配当予想

(円. 銭)

	年間配当金
2014年3月期(計画)	10. 00

下期も攻めの経営は継続

- 新たなビジネスモデルの構築
- プライベートショーを開催
- (新)経営計画の取りまとめ

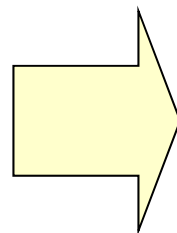
T・S・S(トータル・ソリューション・システム)を展開

10月1日付

社長直轄組織 「T・S・S室」を新設

- ・A/S(アフターサービス)
- ・金型クリーニング
- ・メンテナンスパーツのチェック etc...

TOWAの手で稼働率
を上げる



サービスの
ビジネス化

新事業推進室を新設

10月1日付

社長直轄組織 「新事業推進室」を新設

☆ 10年先のTOWAの事業領域

☆ 技術の横展開により発掘

TOWAプライベートショー 開催

The graphic features a central gold and red checkered pattern. At the top, the Japanese characters '真価へ導く、知の技術。' (Shinka e hodoku, Chiri no Gijyuu) are displayed in black. Below this, the English text 'TOWA Core Technology leads to 'SHINKA = True Value'' is written in black and red. At the bottom, three diamond-shaped icons represent '新化' (Shinka) with 'INNOVATION' below it, '深化' (Shinka) with 'INSIGHT' below it, and '進化' (Shinka) with 'INSPIRE' below it. The TOWA logo and 'PRIVATE SHOW 2013-2014' are repeated on the left and right sides of the central graphic.

2013年12月2日～2014年1月31日

展示内容

①コンプレッションモールド装置

CPM1180 (マニュアルプレス) 超大判660×515mm対応
CPM1080 (オート機) 大判□320mm対応
PMC-D ヒートシンク付PKG対応

②シンギュレーション装置

FMS (マニュアルダイサー) 大判□320mm対応
FMS3040 超高速ピックアップ仕様
(UPH40,000)

③トランスファモールド装置

YPM1180 リリースフィルム対応

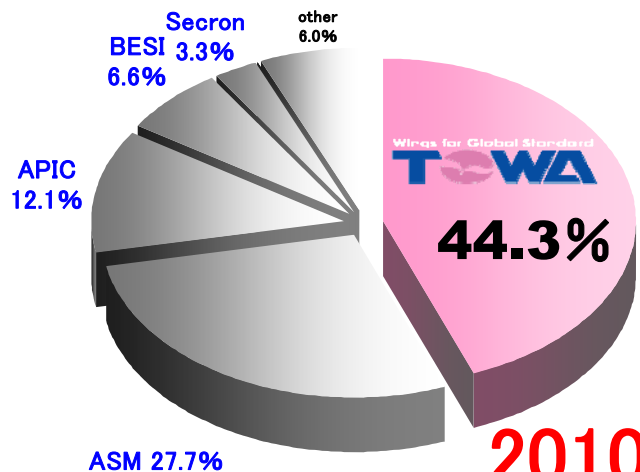
④ナノテクノロジーへの取組み

(新) 中期経営計画

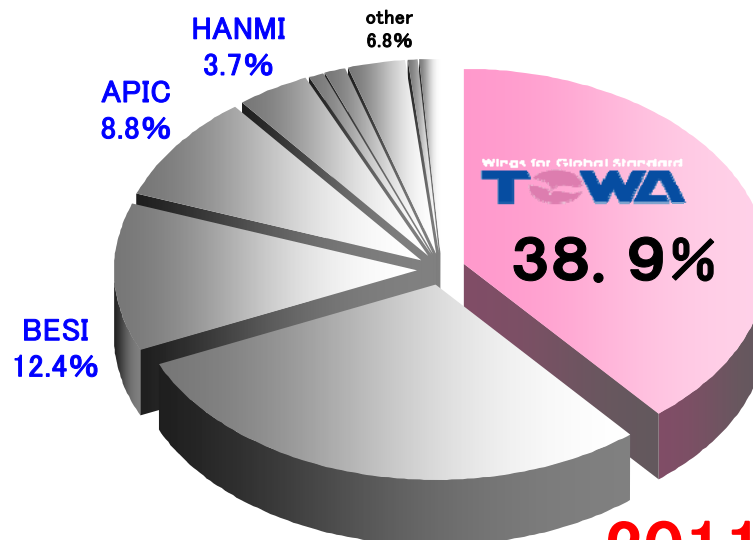
TOWA 「10年ビジョン」

2014年4月～

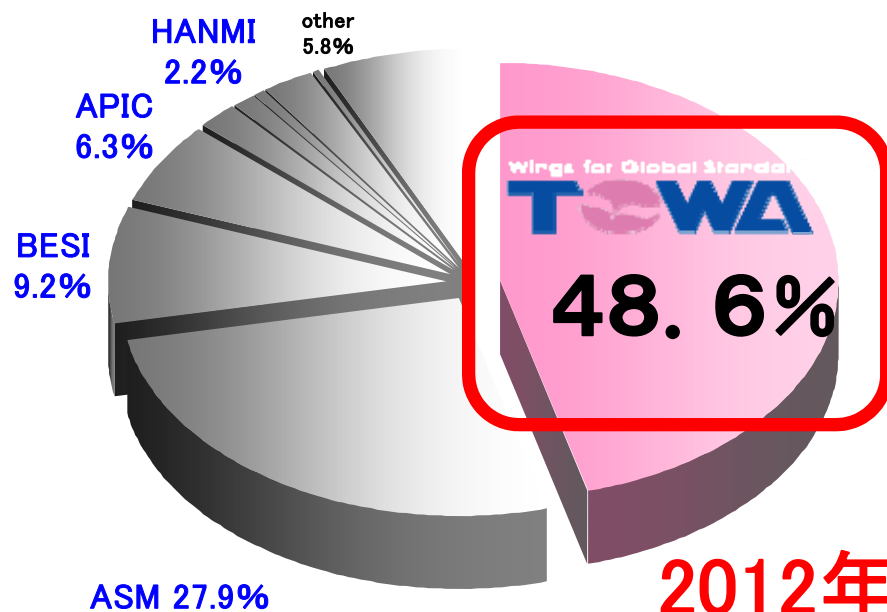
世界オートモールド装置市場シェア



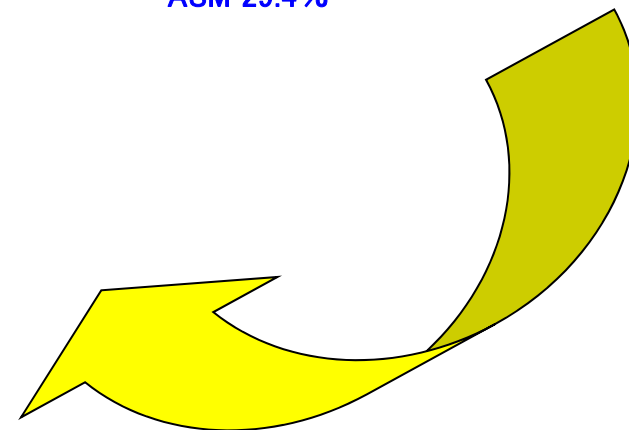
2010年



2011年



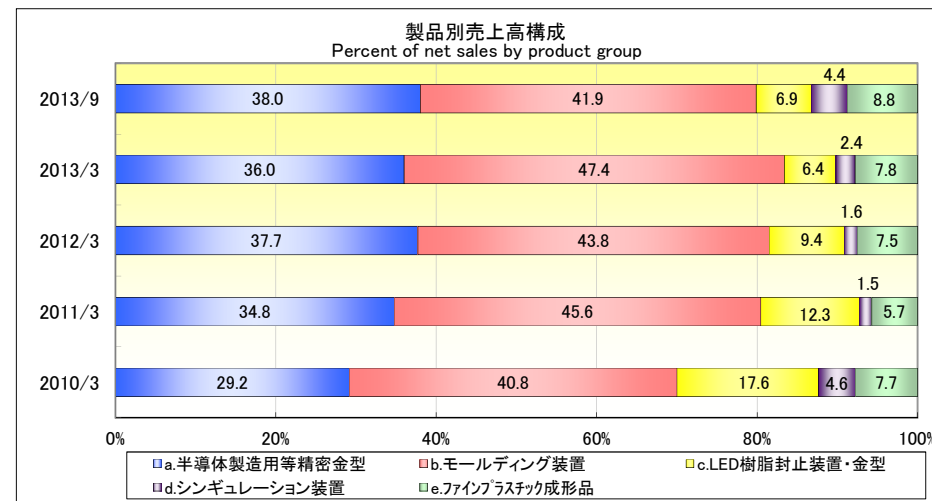
2012年



I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)



①Net sales ②Ordinary income to net sales



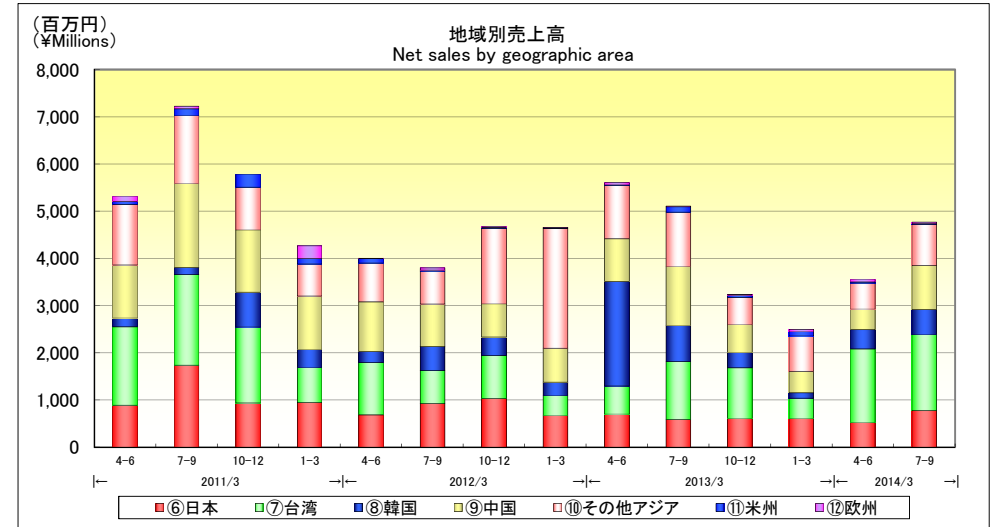
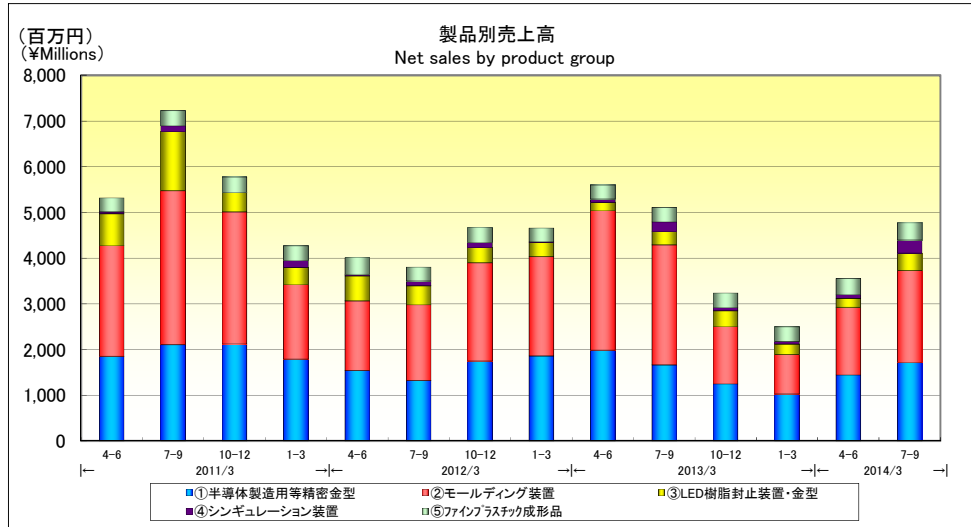
a.Precision molds b.Semiconductor plastic encapsulation systems c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED d.Singulation parts and systems e. Engineering plastic molded products

決算期	Fiscal year	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3E
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions					
売上高	Net sales	14,274	22,592	17,140	16,454	17,000
経常利益	Ordinary income	-345	4,064	1,672	663	270
当期純利益	Net income	-330	3,751	968	691	220
総資産	Total assets	26,738	27,288	26,817	25,896	-
純資産	Net assets	11,091	14,771	15,926	17,072	-
1株当たり指標	Per share data					
1株当たり当期純利益	Net income per share	-13.19	150.00	38.71	27.64	8.80
諸指標	Data					
自己資本当期純利益率	Return on equity	-3.0	29.0	6.3	4.2	-
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	-1.3	15.0	6.2	2.5	-
売上高経常利益率	Ordinary income to net sales	-2.4	18.0	9.8	4.0	1.6
自己資本比率	Equity ratio	41.5	54.1	59.4	65.2	-

(単位: 百万円/¥Millions)

	2012/9	2013/9
売上高	10,715	8,328
経常利益	1,523	100
当期純利益	1,468	52
総資産	27,124	27,210
純資産	16,990	17,207
1株当たり当期純利益	58.70	2.10
自己資本当期純利益率	-	-
総資産経常利益率	-	-
売上高経常利益率	14.2	1.2
自己資本比率	62.0	62.4

II. 四半期売上高動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



製品別売上高 Net sales by product group

(単位: 百万円/¥Millions)

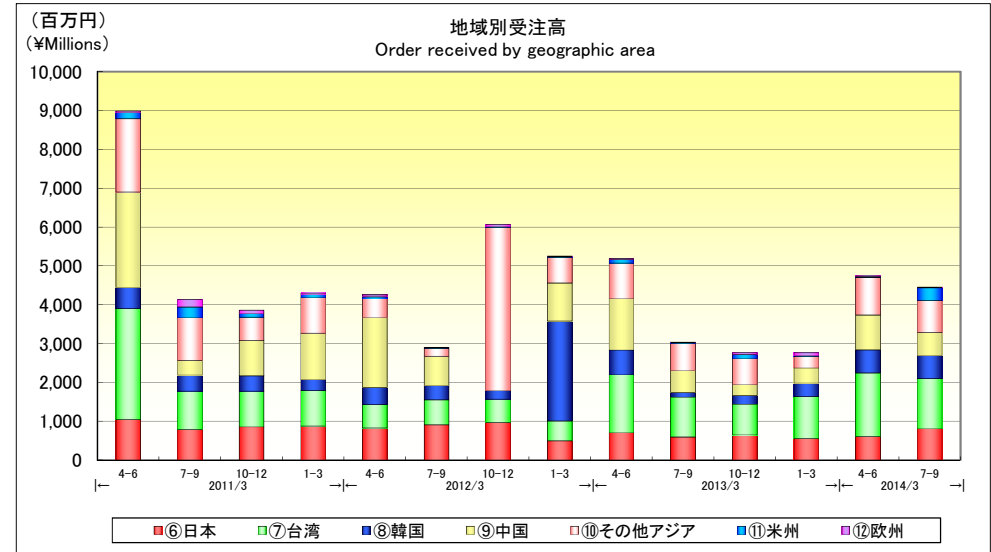
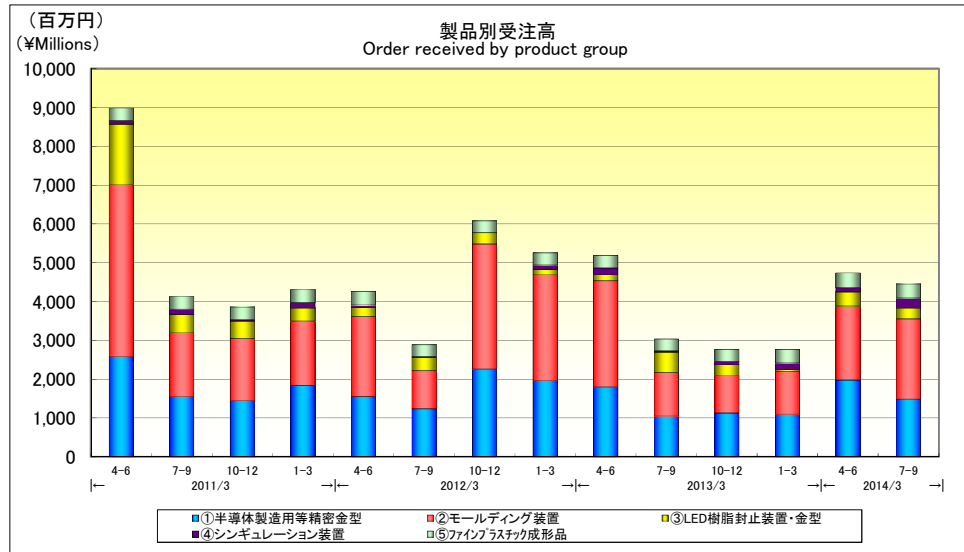
決算期 Fiscal year	2011/3					2012/3					2013/3					2014/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	2,501	16,454	3,555	4,772	8,328
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	1,852	2,104	2,121	1,787	7,866	1,537	1,320	1,745	1,859	6,462	1,984	1,665	1,247	1,026	5,923	1,443	1,723	3,167
モールドング装置 ②Semiconductor plastic encapsulation systems	2,421	3,371	2,888	1,630	10,313	1,529	1,657	2,152	2,173	7,513	3,052	2,623	1,254	870	7,801	1,479	2,007	3,487
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	698	1,290	420	377	2,786	544	418	333	312	1,608	187	299	347	220	1,055	197	378	575
シンギュレーション装置 ④Singulation parts and systems	40	127	13	155	337	38	104	111	12	267	67	204	65	57	395	82	285	368
フィンプラスチック成形品 ⑤Engineering plastic molded products	304	332	332	319	1,289	359	303	323	301	1,287	311	318	322	325	1,277	351	377	729
月平均	1,772	2,409	1,926	1,424	1,883	1,336	1,268	1,555	1,553	1,428	1,868	1,704	1,079	834	1,371	1,185	1,591	1,388

地域別売上高 Net sales by geographic area

(単位: 百万円/¥Millions)

決算期 Fiscal year	2011/3					2012/3					2013/3					2014/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	2,501	16,454	3,555	4,772	8,328
日本 ⑥Japan	889	1,735	936	943	4,507	688	925	1,030	675	3,320	702	590	614	614	2,521	527	772	1,299
台湾 ⑦Taiwan	1,661	1,920	1,611	751	5,945	1,103	695	912	421	3,132	595	1,227	1,068	423	3,314	1,556	1,619	3,175
韓国 ⑧Korea	187	152	737	380	1,458	237	510	393	282	1,423	2,215	764	329	119	3,428	408	528	937
中国 ⑨China	1,125	1,786	1,319	1,130	5,363	1,050	903	701	718	3,374	903	1,248	583	453	3,189	436	926	1,362
その他アジア ⑩Other asia	1,279	1,431	904	675	4,291	823	688	1,598	2,539	5,649	1,129	1,151	575	748	3,604	543	870	1,413
米州 ⑪America	70	145	268	117	602	94	32	25	11	164	14	112	53	89	269	31	20	52
欧州 ⑫Europe	103	55	0	270	423	10	47	4	11	74	44	16	12	52	126	51	34	85

Ⅲ. 四半期受注高動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



製品別受注高 Order received by product group

(単位: 百万円/¥Millions)

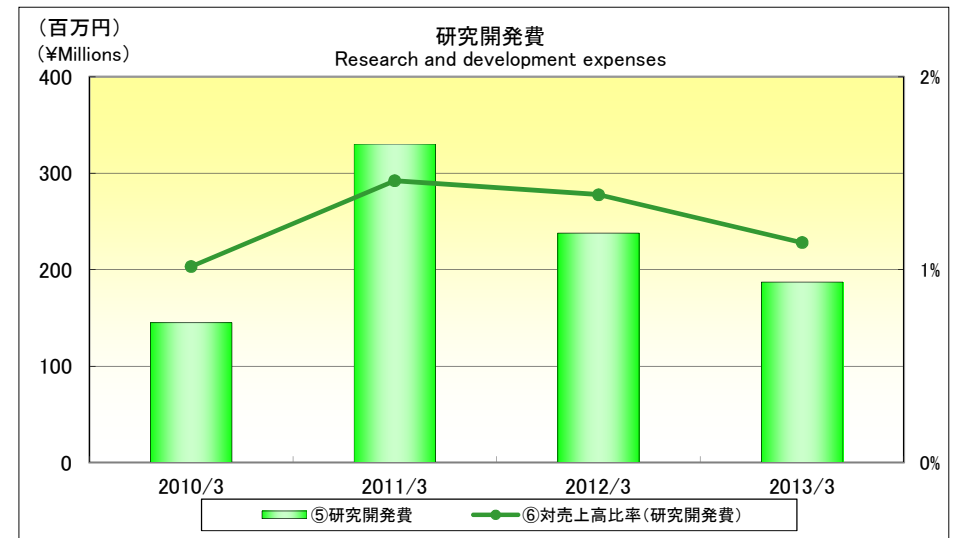
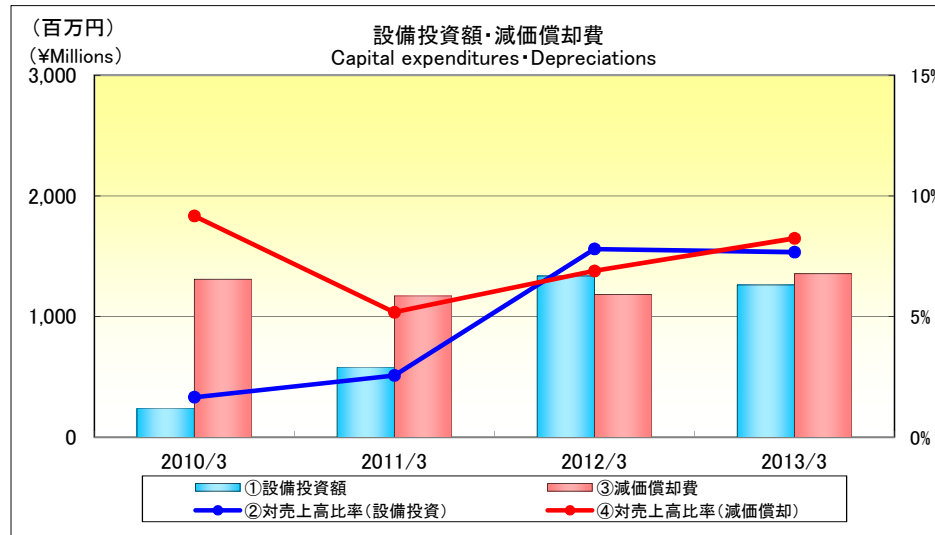
決算期 Fiscal year	2011/3					2012/3					2013/3					2014/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	2,763	13,759	4,740	4,454	9,195
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	2,587	1,554	1,455	1,841	7,438	1,558	1,236	2,263	1,969	7,028	1,797	1,052	1,131	1,101	5,083	1,980	1,490	3,470
モールドディング装置 ② Semiconductor plastic encapsulation systems	4,437	1,651	1,587	1,657	9,334	2,055	982	3,221	2,720	8,978	2,741	1,119	970	1,103	5,934	1,904	2,067	3,972
LED樹脂封止装置・金型 ③ Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	1,546	465	454	335	2,801	227	348	289	147	1,013	168	529	270	53	1,021	365	275	640
シンギュレーション装置 ④ Singulation parts and systems	101	132	35	142	411	73	16	-29	103	164	160	30	90	158	439	107	257	364
ファインプラスチック成形品 ⑤ Engineering plastic molded products	316	327	326	327	1,298	350	307	309	313	1,281	322	306	304	346	1,279	383	362	746
月平均	2,996	1,377	1,286	1,435	1,774	1,422	964	2,018	1,752	1,539	1,730	1,013	922	1,147	1,580	1,485	1,533	

地域別受注高 Order received by geographic area

(単位: 百万円/¥Millions)

決算期 Fiscal year	2011/3					2012/3					2013/3					2014/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	2,763	13,759	4,740	4,454	9,195
日本 ⑥ Japan	1,038	781	853	875	3,548	821	906	963	495	3,187	703	593	645	551	2,494	602	802	1,404
台湾 ⑦ Taiwan	2,863	992	921	913	5,691	615	642	602	512	2,372	1,492	1,027	793	1,079	4,392	1,639	1,299	2,939
韓国 ⑧ Korea	546	415	395	277	1,635	435	375	219	2,573	3,604	637	119	219	352	1,328	592	583	1,175
中国 ⑨ China	2,456	376	907	1,198	4,938	1,801	746	-8	981	3,520	1,327	564	284	389	2,566	902	598	1,500
その他アジア ⑩ Other asia	1,886	1,108	601	921	4,518	503	196	4,202	657	5,559	912	704	668	293	2,579	966	823	1,790
米州 ⑪ America	168	268	95	90	623	44	19	27	25	117	99	16	112	34	263	17	330	347
欧州 ⑫ Europe	29	188	84	26	329	43	4	46	9	104	16	13	42	62	134	20	16	36

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結)	(Consolidated)	(単位: 百万円/¥Millions)				
決算期	Fiscal year	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2013/9
キャッシュフロー	Cash flows					
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	2,494	5,571	1,897	2,710	8
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-290	-620	-112	-1,083	-857
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	-2,733	-3,808	-2,280	-817	209
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents	3,836	4,933	4,395	5,266	4,623
設備投資額	①Capital expenditures	236	578	1,336	1,262	524
対売上高比率	②Ratio of sales	1.65	2.56	7.79	7.67	6.29
減価償却費	③Depreciations	1,309	1,170	1,181	1,354	621
対売上高比率	④Ratio of sales	9.17	5.18	6.89	8.23	7.46
研究開発費	⑤Research and development expenses	145	330	238	187	63
対売上高比率	⑥Ratio of sales	1.02	1.46	1.39	1.14	0.76

この資料に関するお問い合わせ

TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5

Tel : 075-692-0251

Fax: 075-692-0270

http://www.towajapan.co.jp/contact/i_ir/index.htm

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。